

# 自動レーザーマーキング装置

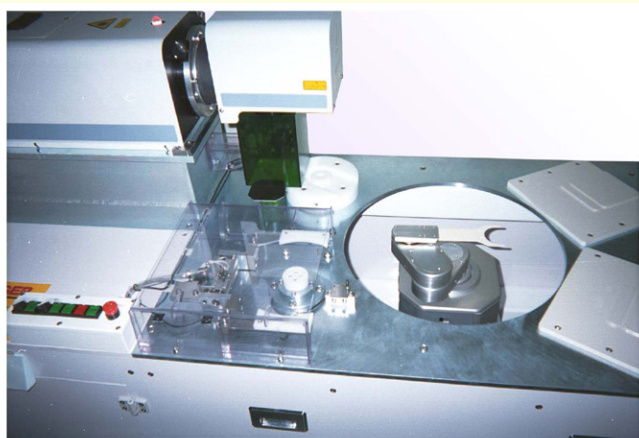
**適 用**：本装置はYAGレーザーマーカ装置を組み込み、全自動でシリコンウェハの表面に印字するものです。


**特 徴**：シリコンウェハの表面に印字するもので、バスケットからバスケットへと全自動でマーキングします。また、特殊な素材・メッキ面に錆にくい文字として、小さな文字も鮮明に、曲面にも高速でマーキングします。

**仕 様**：ウェハ サイズ 8インチ, 6インチ  
厚 み 0.5 ~ 2.0 mm  
オリフラ形状 8インチ オリフラ 1ヶ所  
                        ノッチ 1ヶ所  
                        6インチ オリフラ 1ヶ所  
処理枚数 1カセット25枚以内 (カセット段高さ160mm以内)  
処理時間 40sec/1枚  
印字位置 オリフラ位置に対して360° (設定は1° 単位)

**外形寸法**：マーキング装置本体 2000 mm(W) × 820 mm(D) × 1225 mm(H)

**重 量**：マーキング装置本体 520 kg



**SFTech**  **株式会社住友金属ファインテック**

〒582-0004 大阪府柏原市河原町1番22号 営業部 TEL 072-972-1962  
<http://www.smi-finotech.co.jp> FAX 072-972-1967